

# 有研半导体硅材料股份公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展，提升公司投资价值，维护公司全体股东利益，于2025年3月31日披露了《有研硅2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月14日披露了《有研硅关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2025年，公司积极开展并落实相关工作，在推动公司经营稳步发展、保障投资者利益、树立良好的资本市场形象等方面取得成效。

为切实履行上市公司的责任和义务，进一步推动公司业绩与治理水平提升，公司结合自身发展和经营情况，制定了《有研硅2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，同时规划了2026年主要措施。具体情况如下：

### 一、深耕核心主业，筑牢发展根基

2025年，全球半导体市场呈现显著结构性分化，人工智能技术爆发驱动逻辑、存储芯片需求攀升，但功率半导体受汽车电子需求下行、行业库存高企的影响景气度低迷。在复杂多变的行业环境下，公司坚守“聚焦主业、创新驱动”的初心，深耕半导体硅材料核心业务、不断加大研发投入、深入推进降本增效、持续推进原辅材料国产化，全年实现营业收入100,524.57万元，利润总额28,720.29万元。

在产能建设方面，全年实现硅片产销量同比增长，其中，8英寸硅片产销量创历史新高，产量与销量分别实现同比25%、20%的增长。红磷超低阻、区熔滤波、MCz等产品销量取得突破，区熔单晶产品实现产销量大幅增长。

报告期内，公司募投项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”于2025年12月结项，实现新增8英寸硅片产能10万片/月的目标。为更好地满足市场需求，提升公司产品交付能力，公司已于2025年10月启动“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，计划再新增月产能5万片，项目完成后，8英寸硅片总产能将达到

30 万片/月。

“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”在前期完成厂房建设基础上，基于对当前市场环境的深入研判，调整了项目投资的节奏和部分设备配置。公司将优先推进对应产能的市场开拓，确保产能充分释放，预计项目于 2026 年底完成。报告期内，公司积极推进部件类产品国内市场推广和客户验证，部分产品已通过国内龙头设备厂认证。公司近年研发的多晶新产品，已通过国内外客户的认证，并于 2025 年四季度实现批量供货。

面对激烈的市场竞争，公司通过积极开展多项降本和技改项目，实现降本增效，提升产品价格竞争力，从而保持了稳定的产品毛利率。在原辅材料和设备国产化方面，公司不断加大国产采购力度，全年国产原辅材料采购金额占比提升 4 个百分点。公司密切关注原辅材料市场行情，及时调整价格策略并加大谈判力度，启用供应商竞价系统，积极开发新供应商，在有效降低采购成本的同时，进一步增强公司供应链的稳定性与安全性。

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司将继续深耕集成电路产业核心业务，通过技术创新与工艺突破，全面巩固并增强在半导体硅材料领域的技术领先地位与市场竞争力，夯实主业发展根基。具体包括以下几个方面：

坚持半导体硅片与集成电路刻蚀设备用硅材料双轮驱动的发展模式，按计划稳步推进“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”、“8 英寸区熔硅单晶扩产项目”及“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”。同时，持续加快新品的研发速度，确保新品顺利通过客户验证，不断丰富产品矩阵，不断提升高附加值产品占比，为后续市场拓展奠定坚实基础。

坚持国内市场与国外市场双线推进，持续加大市场开发力度，以市场为导向，培育发展一批全球范围内的战略性客户，同时积极挖掘潜在客户，分析客户内在需求，加快销售渠道建设，重点发展与核心客户的战略合作关系，支撑公司长期成长。

持续深入推进提质增效工作，通过技术提升与管理优化双管齐下，进一步降低运营成本。同时，全力确保硅片产品保持高稼动率，巩固并进一步扩大成本优势。此外，公司将继续深入推进原辅材料、设备国产化工作，以增强供应链的自主可控能力。

## 二、加强前瞻布局，培育增长新动力

2025年，公司围绕产业链上下游积极布局，持续拓展产业服务能力，优化产品结构，加快培育新的利润增长点，不断提升公司综合竞争实力。

报告期内，公司积极推进收购株式会社DG Technologies（以下简称“DGT”）股权项目，并于2026年1月完成对DGT的收购。此次收购有助于公司进一步延展产业链、补齐后道加工环节，为客户提供终端产品及一站式服务。后续，DGT将在有研硅的管理构架下构建自主的采购和销售体系。公司将进一步发挥DGT的客户资源，不断扩大半导体设备用零部件产品规模，并争取扩大海外市场份额。

报告期内，公司控股子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）与山东恒圣石墨科技有限公司共同出资设立了山东研晶石英科技有限公司，注册资本2,000万元，布局半导体石英坩埚的生产与销售。新公司具备生产24-32英寸半导体石英坩埚和33-36英寸光伏石英坩埚的能力。未来，公司将进一步发挥产业协同优势，不断开拓半导体石英坩埚市场。

2026年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》，拟设立全资子公司“国晶半导体材料(包头)有限公司”(公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准)，并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，该项目计划总投资人民币40,000.00万元，其中拟使用超募资金19,470.15万元、自有资金20,529.85万元。

未来，公司将围绕集成电路产业链和公司发展战略，积极拓展新业务，为公司高质量发展赋予新动能。

## 三、聚力研发创新，汇集人才力量

### 1、加大研发力度，激发创新活力

2025年，公司深入实施创新驱动发展战略，以产业升级为导向，持续加大科技创新投入力度。报告期内，公司累计投入研发费用9,241.43万元，较去年同比增长18.05%，占营业收入的9.19%。截至报告期末，公司拥有有效授权专利155项，其中发明专利115项，实用新型专利40项。新颁布国家标准1项。

有研硅获得第六届中国电子材料行业半导体材料专业前十企业。控股子公司山东有研半导体获批工信部第九批制造业单项冠军企业，入选德州市2024年先进

制造业百强企业“综合实力50强”。公司与控股子公司山东有研半导体联合开发的“520mm及以上超大尺寸单晶硅创新与技术提升”项目荣获全国机械冶金建材职工技术创新成果一等奖。山东有研半导体作为依托单位建设的“山东省硅单晶半导体材料与技术重点实验室”成功通过山东省科技厅验收，并获评“优秀”等级；开展CCz连续拉晶工艺开发，储备单晶连续生长技术。

报告期内，公司积极推进新产品研发与技术创新，加快传统产品的升级迭代。2025年，公司8英寸MCz、8英寸区熔气掺硅片及硅部件成品等多项新产品相继通过客户认证，并实现批量销售；重掺红磷更低阻产品在多家客户实现批量供应。控股子公司山东有研半导体成立晶体研发中心，为后续晶体技术研发与产品升级提供组织保障。

2026年，公司将继续加大对新产品、新技术的研发投入，进一步加快科技成果转化，优化产品结构，提升高附加值产品的占比。通过技术创新与工艺突破，巩固并增强在半导体硅材料领域的技术水平与市场竞争力，为公司产业发展提供创新驱动力。

## 2、优化人才机制，汇聚人才力量

报告期内，公司持续完善人力资源管理体系和激励机制，多措并举优化人才政策，着力打造“科技骨干人才、优秀经管人才和专业技术人才”矩阵，完善管理、技术、操作三序列职业发展通道。公司持续推进“星辰计划”的实施和模范员工评选工作，推进职业技能自主评价机制的建立，加大对优秀年轻人员的选育力度，为公司长远发展储备后备力量。按计划开展股权激励的授予、行权等工作，持续激发核心人才活力。

2026年，公司将进一步推进人才体制机制改革，不断提升组织管理效能。围绕战略方向开展人才盘点，做好人才梳理和人才储备工作，通过机制体制创新加速培养和储备技术骨干力量；加大培训力度，开展专项管理培训，丰富专业技术培训，提高培训效果；持续推进绩效管理KPI+考核模式，进一步加大研发创新、降本增效、管理创新激励力度；同步开展员工满意度和专项调研工作，做好配套制度完善，不断提高员工满意度和企业文化认同。

## 四、强化资金管控，提升运营效能

### 1、加强成本控制，保持盈利质量

2025年，公司通过优化管理机制，积极打造高效协同的内部运营流程，建立预算动态管控机制，实行定期滚动预测，定期召开经营分析会。同时，开展成本分析工作，对比实际单耗成本与预算成本、历史成本的差异，分析成本变动原因，找出成本控制的关键点和薄弱环节，增强成本控制能力。

2026年，公司将持续强化成本精细化管理和流程优化，在保证产品质量的前提下降低成本，进一步提升产品市场竞争力。

## 2、加强现金管理，优化资金使用配置

2025年，在保障公司经营效率的前提下，公司主要通过以下方式，提高资金使用效率：（1）持续关注经营回款，不断优化库存结构，维持健康的经营性现金流，全年经营活动现金净流入27,419.07万元，确保储备安全的经营现金，保持高效的资金使用效率。（2）在募集资金使用方面，在募投项目实施过程中严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，促进公司主营业务发展。在董事会审议授权和有效控制资金使用风险的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品。（3）在自有资金方面，公司在不影响正常经营需求和保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，均获得了良好的收益。（4）持续关注上下游并购投资机会，2026年1月完成对DGT公司70%股权的收购，为公司优化资源配置，提升产业协同效应，实现长期稳定发展提供了助力。

2026年，公司将继续加强资金管理，在现金流管理、自有资金使用和并购整合上加大力度。继续关注扩大产业链条机会，增强协同互补。

## 五、健全公司治理，筑牢内控防线

### 1、优化治理结构，提升决策效能

2025年，公司紧跟监管要求，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现有组织架构进行优化调整，取消监事会，明确由董事会下设的审计委员会承接原监事会的法定监督职能，推动治理体系持续升级。同步对《有研半导体硅材料股份有限公司章程》有关条款进行修订，完成对36项治理制度的更新与修订，

新增公司治理相关制度3项。

报告期内，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，结合当前行业发展趋势及公司实际情况，公司将原董事会下设“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。

2026年，公司将持续关注相关法律法规的更新，及时修订相关制度，确保公司制度健全、运作规范；同时持续优化完善公司治理机制，更好地发挥董事会履职能力，确保公司重大经营事项的有效落实，股东会、董事会规范有效运作。

## 2、深化内控建设，强化风险防范

2025年，根据公司《内部控制基本规范》及《内部审计制度》的要求，公司进一步提高内控管理工作效率，完成内控自评价工作。梳理并完善公司各项规章制度，优化内部控制环境，提高内部控制管理水平，定期检查制度建设与执行情况，保障企业依法合规经营。

2026年，公司将持续加强内控管理，围绕公司重点风险领域及关键环节开展专项审计及监督检查工作，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康可持续发展。

## 3、赋能关键队伍，提升履职水平

报告期内，公司积极组织全体董事、高级管理人员通过上海证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会等平台开展专题培训，重点学习了资本市场最新监管政策、公司治理、合规运作等内容，实现必修课完成率100%。通过培训学习，切实提升了管理团队的专业履职能力，推动公司规范运作水平和治理成效进一步提升，为公司和全体股东权益提供了更有力保障。

2026年，公司将继续提升董事、高级管理人员的专业素养，通过常态化参与监管培训，精准把握政策动态，确保董事及高管勤勉履职。同时，公司将加强与董事、高级管理人员的互动沟通，通过分享监管案例与市场实践等方式，多维赋能治理决策，筑牢高质量发展根基，全力保障全体股东的合法权益。

## 六、加强投资者沟通，提升信披透明度

公司高度重视信息披露工作，严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》

和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司累计发布定期报告4份，临时公告45份。公司在2024-2025年度沪市上市公司信息披露工作评价中荣获“A”级，《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》在万得(Wind)、中诚信绿金的ESG评级中均被评为“A”级。此次评级提升与奖项荣誉，以实绩验证了公司在可持续发展领域的改进和优化，并为公司提升企业形象、优化投资者关系、增强市场竞争力等方面带来了积极影响。

2025年，公司持续加强与投资者的沟通交流，报告期内召开3次业绩说明会，2次投资者交流会，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等积极参与交流，系统全面介绍了公司经营成果、产业发展、未来规划等，并就投资者重点关注的问题进行了充分交流。公司及时回复上市e互动问题，保证回复率100%，同时通过投资者热线、电子邮件等多种渠道与投资者保持交流，及时解答市场关切，准确传递公司价值，切实提升市场信心。

2026年，公司将严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，积极履行各项信息披露义务，全面提升公司信息披露的质量和透明度，确保准确、清晰、高效地传达公司信息。公司将进一步深化与资本市场的双向互动，健全投资者沟通机制，拓展交流形式的广度与深度。通过紧密追踪市场动态与投资者关注焦点，公司将及时、有效地回应各方诉求，切实维护投资者权益。

### **七、持续完善投资者回报机制，提升投资价值**

2025年，公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策，持续与投资者共享经营成果。根据2024年年度股东会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东共计派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。公司已于2025年6月完成2024年度现金分红派发工作，全体股东获得相应投资回报，切实提升了股东获得感。

2026年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。利润分配方面，公司2025年度拟以

实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利68,571,058.71元（含税），本年度公司现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.77%。

#### **八、强化管理层与股东的利益共担共享约束**

公司董事会于2025年3月14日审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意向34名激励对象授予90.00万份股票期权；2025年10月27日审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意92名激励对象以9.05元/股的价格行权268.08万份股票期权，有效绑定核心骨干与公司及股东的长远利益。高级管理人员的绩效考评与薪酬兑现严格与公司整体业绩及分管领域KPI达成情况挂钩，由董事会薪酬和考核委员会监督执行。公司治理层与管理层保持密切沟通，战略方向高度一致，共同致力于公司价值创造与股东利益最大化。

2026年，公司将根据新规，持续完善董事、高管薪酬制度，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共享。

#### **九、明确权责要求，强化“关键少数”**

2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，组织“关键少数”人员参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的治理体系，对控股股东、实际控制人及董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

#### **十、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披

露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年3月27日